

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
 定時株主総会 毎年6月
 基準日 毎年3月31日
 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 フリーダイヤル 0120-782-031
 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の
 本店および全国各支店で行っております。

株主通信

2026年3月期(第54期)事業報告
 2025年4月1日～2026年3月31日

特集 躍進する光製品事業の競争優位性
 — 精工技研の成長を加速させる“技術×現場力”

ホームページのご案内

当社ホームページでサステナビリティサイトを
 リニューアルいたしました。

サステナビリティサイトでは環境・社会・ガバナンスに関する取り組みや考え方を、より分かりやすくご紹介しています。また、個人投資家向け説明会や決算説明動画も配信しており、業績ハイライトや今後の戦略、業績予想のポイントについてご説明しておりますので、ぜひご覧ください。今後も株主・投資家の皆様にタイムリーで分かりやすい情報発信を行い、IR活動のさらなる充実に努めてまいります。



個人投資家向け説明会



決算説明動画



IRサイトはこちら

<https://www.seikoh-giken.co.jp/irinfo/index.html>



表紙写真コーナー

● 撮影場所／昭和記念公園（東京都立川市） ● 撮影者／当社社員 増田 尚哉
 「一面に咲くネモフィラが一輪ごとに様々な色をしていて、とてもいい景色が広がっていました。」



株式会社 精工技研

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台296番地の1
<https://www.seikoh-giken.co.jp>



業績ハイライト

2026年3月期は、売上高・各利益とも過去最高を更新。
中期経営計画を1年前倒しで達成し、
さらなる成長に向けた取り組みを推進してまいります。



代表取締役社長 上野 淳

2026年3月期の業績について

当社グループが関わる情報通信・エレクトロニクス関連市場においては、生成AIの社会実装が進展し、米国大手IT企業を中心に高度なAIサービスの商用化が拡大しました。一方、中国企業による低コスト・高性能モデルの開発も進み、価格競争と技術革新が進行しました。また、データセンター需要の急拡大を背景に、省電力化を実現する半導体や冷却技術、光電融合分野の技術開発も進展しました。自動車関連市場においては、日系メーカーの生産は緩やかな回復に留まる一方、電動化の加速に伴い、欧米・中国メーカーによる競争が激化しました。

こうした中で当社グループは、中期経営計画「マスタープラン2022」に基づき各施策の遂行に努めました。

「顧客接点の活性化」に向けては、国内外展示会への出展やホームページ活用、商社や販売代理店との連携強化により、新規顧客開拓と商談数の増加に注力しました。

「新製品・新技術開発の加速」に向けては、精機事業において住友重機械工業株式会社様と共同開発した型内塗装技術「SSIMC」

のシステム販売に向け、引き続き技術力の研鑽に取り組み、光製品事業ではデータセンター向け多心光コネクタ等の開発を進めました。

「ものづくり力の強化」に向けては、自動化を含む生産体制の強化や仕入先・外注先との関係強化に努めました。また、タイに設立したSEIKOH GIKEN (THAILAND) での光通信用部品量産化、中国河南省での新会社設立など、次世代光通信デバイスの生産能力増強を図りました。

「経営基盤の強化」に向けては、健康経営や環境維持活動の推進、情報セキュリティ体制の強化にも取り組みました。

これらの結果、当期の売上高は30,087百万円、営業利益は7,733百万円となりました。株式会社エムジーの連結子会社化や高付加価値製品の拡販により収益性も向上し、売上高・営業利益はいずれも過去最高を更新するとともに、中期経営計画で掲げた2027年3月期の目標を1年前倒しで達成。経常利益は8,139百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は6,210百万円となり、売上高、各段階利益とも前期から大きく成長しました。

セグメント別の業績について

● 精機関連

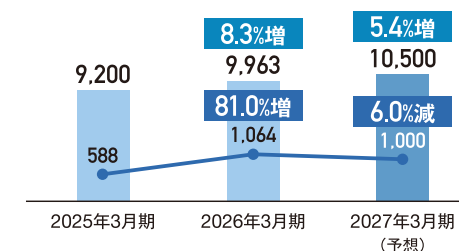
精機関連では、車載用センサー関連部品の売上は堅調に推移したものの、電気自動車向けの部品や金型の売上は減少しました。一方、2024年10月に連結子会社化した株式会社エムジーは車載用コネクタや事務用部品を量産成形しており、損益面で寄与しました。開発面では、精密金型技術や射出圧縮成形技術、微細転写技術等を活用し、自動車、医療、バイオ等の産業領域において、お客様と共に新たな精密成形品の量産化に向けた技術課題の解決に取り組みました。これらの結果、当期の精機関連の売上高は9,963百万円となり、過去最高を更新することができました。

● 光製品関連

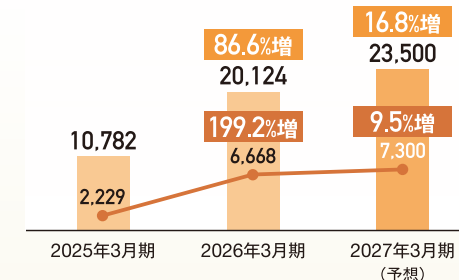
光製品関連では、生成AIの普及拡大を背景に世界中でデータセンターの建設が進み、データセンター内で用いられる光通信用部品の需要が急増しました。これにより、データセンター用の光コネクタや、その製造時に使用される光コネクタ研磨機や検査・測定装置の売上高が大きく増加しました。当期は、タイの子会社SEIKOH GIKEN (THAILAND) Co.,Ltd.においても光コネクタの量産を開始したほか、2026年1月に中国河南省に精工迅捷光電（鶴壁）有限公司を設立し、多心光ファイバを高精度に接続する部品の量産体制を整えました。これらの結果、当期の光製品関連の売上高は20,124百万円となり、過去最高を更新しました。

売上高・営業利益の推移 (単位:百万円)

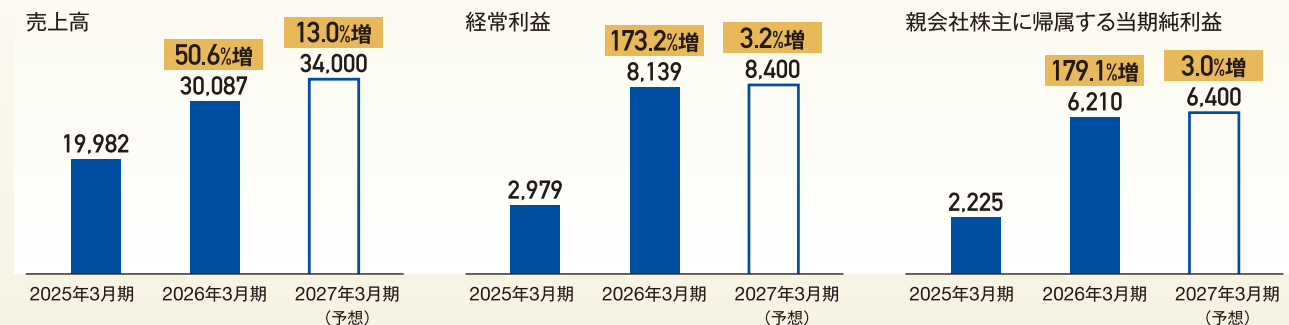
● 精機関連 精密成形品/精密金型/その他
■ 売上高 ● 営業利益



● 光製品関連 光通信用部品/製造機器・装置/その他
■ 売上高 ● 営業利益



連結損益計算書の概要 (単位:百万円)

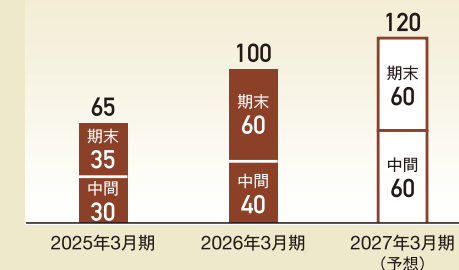


期末配当を期初予想から20円増額、年間配当100円に修正

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、将来の投資に備えるための内部留保を考慮しながらも、配当金の水準を安定的に維持、向上させていくことを株主還元の基本的な方針としております。

上記の基本方針、並びに当期業績の順調な推移を勘案し、当期の期末配当を期初予想の40円から20円増額し、1株当たり60円に修正。これにより年間配当は中間配当と合わせて1株当たり100円（前期比35円の増配）となります。なお、2027年3月期は年間20円増配の120円（中間配当60円、期末配当60円）となる予定です。

一株当たり配当金 (単位:円)



躍進する光製品事業の競争優位性

— 精工技研の成長を加速させる“技術×現場力” —

旺盛なデータセンター需要によって、光コネクタ、研磨機を中心とする光製品事業の収益が拡大しています。事業の特徴や市場における優位性はどこにあるのでしょうか。上野淳社長、光学製品事業部長の佐藤英明執行役員、製造や購買、生産管理を担う事業運営部長の柿沼憲宏執行役員の三者に語っていただきました。



執行役員/光学製品事業部長

佐藤英明

代表取締役社長

上野淳

執行役員/事業運営部長

柿沼憲宏

Q1 2026年3月期は連結売上高の約3分の2を光製品事業が占め、グループの成長を牽引しました。事業の特徴、競争優位性について改めて教えてください。

A 技術部門と現場の一体感が最大の強み。事業部間の連携も多くのシナジーを生み出しています。

上野 光製品事業の強みは、通信やセンシング分野に不可欠な光学製品と、それを安定的に量産する機器・装置の基盤技術を併せ持ち、部品から装置まで一貫対応できることです。そして、いかなる課題に対しても、技術部門（技術開発・営業）と現場（製造・生産管理・購買）が一体となって解決策を提案できること。私はこの2つが市場における圧倒的な競争優位性を生み出していると考えています。

佐藤 光学製品事業部長の立場から申し上げますと、一番の強みはファイバ・アセンブリ（組立技術）を軸とする量産能力です。我々のお客様の製品は小型・集積化がますます進み、当社に求められるファイバ・アセンブリは極小サイズになっています。極小部品を用いた高精度な組立（ファイバ挿入・位置合わせ・接着・研磨）から検査・梱包まで一貫生産・多量生産対応できる企業は限られています。当社のファイバ・アセンブリは日米中の光デバイスメーカーで多数採用されています。また、製造の自動化を進めるだけではなく、自動化設備そのものを自社で開発・製造できることや、機械工学を専門とするエンジニアが多く、彼らが大いに活躍できる環境を整えていることも、市場での優位性につながっていると自負しています。

柿沼 現場目線で言えば、技術部門と現場が密に連携してコスト・品質管理に取り組み、あらゆるお客様の要望にお応えできるのが強

みだと思います。セグメントは光製品事業と精機事業に分かれていますが、事業部の連携によってさまざまなシナジーを生み出しています。

佐藤 一番のシナジーは量産立ち上げとキャパ拡張のスピードアップです。光製品事業部のコネクタ設計技術者と精機事業部の金型設計技術者は、製品の設計ポイントや金型構造、成形条件、製造工程を相互理解しています。これが製品開発やキャパ拡張時の課題解決において大いに時間短縮できる理由です。自動化については今、事業部を横断する協議を行っており、新たなアイデアがどんどん出てきています。

上野 今後の課題は、グローバル市場における一体感の維持です。この4年間で中国、タイに生産拠点を新設しましたので、グローバルな目線で仕事ができる人材の採用と育成が急務と考えています。

佐藤 年に2回、世界各国の拠点の責任者を日本に集めて開催している国際経営会議でも製品開発や事業戦略について協議し、一体感の醸成が図られています。

Q2 当期、データセンター向け光学製品の旺盛な需要によって発生した課題と、課題解決のために実行された施策について教えてください。

A 人員の増強と生産環境の最適化、新規設備の導入、複数購買などの施策を段階的に進め、キャパシティを前期比で約4倍まで高めました。

上野 本社（千葉・松戸工場）で製造している光コネクタ研磨機の需要が3～4倍に急増。部材の供給や組立のキャパシティを大幅に超えてしまい、生産が追いつかない状況になりました。通常、受注から出荷までのリードタイムは2ヵ月ほどですが、2026年3月期の上期

以降は5ヵ月もお待ちいただく事態になっています。この状況が続けば受注を失うリスクがありましたので柿沼事業運営部長を中心に対策を検討し、実行しました。

柿沼 ただちに取り組んだのは組立人員の増員です。当社の製造部門内で人員配置の最適化を図るとともに、製造員の増員を実施し、人員を4倍に増強しました。併せて作業のスペースや設備の稼働時間の最適化、新たな工作機械の導入などを行い、生産力を引き上げました。その一方で供給力の底上げにも着手。部材の仕入れ先を増やし、協力会社との連携を強化して、部材の安定的かつスピーディな仕入れとリスク分散を実現できる体制を構築しました。これらの施策をとって生産能力を大幅に拡大し、前期末比で約4倍の生産体制を構築中です。これにより受注機会を最大限取り込むことが可能となり、売上の成長と収益力の向上を実現することができました。現在もさらなる受注増加に対応すべく、生産体制の強化、協力会社との連携拡大、工程改善を継続的に進めています。

上野 それでも受注と生産のバランスが100%改善できたわけではありません。光コネクタ研磨機の需要は依然として旺盛で、グローバル市場ではさらなるリードタイムの短縮を要求される可能性も十分に考えられます。現状に満足することなく、そうした事態に直面しても柔軟に対応できるように今後も現場力と技術力を高めていく必要があります。

Q3 株主・投資家の皆様の期待に応え、さらなる成長、収益の拡大を実現するためのポイントは？

A 光ファイバ接続技術の追求と課題解決力の向上に努め、活況が続く市場の変化に対応します。

佐藤 光ファイバを接続するための技術を追求し続ける。それが、我々が活躍の場を広げ、成長を続けていくための使命と考えています。現在、すさまじいスピードで進化するAI化・自動化の技術に

対応するために、データセンターの需要はさらに高まっています。そしてその中でCPO（Co-Packaged Optics：光学部品と半導体チップを同じパッケージ内に組み込み、データ転送速度の向上と電力消費の削減が可能になる）をはじめとする技術が注目を集めています。さらには小型・集積化された次世代型の光デバイス、モジュールも続々と登場しています。しかし、我々の使命は変わりません。どこよりも信頼性の高い光ファイバ接続を実現する。お客様の期待もそこにあると確信しています。

柿沼 データセンター需要の拡大により、ボトルネックとして発生する課題にいかんして対応するか。それが重要なテーマになると考えています。生産面では、熟練技術者の確保・育成と、主要部材や加工品の調達。品質面では、新たな人材や協力会社を活用する中で、いかんして作業レベルの安定化を図るのがポイントになります。その課題の解決策として準備しているのは、自動化・省人化設備への投資と、作業工程と現場レイアウトの見直し、進捗状況の見える化です。協力会社との連携強化や多能工化（一人の社員が複数のスキルを身につけること）も並行して進め、予期できない市場の変化にも柔軟に対応できる体制を整えていきます。

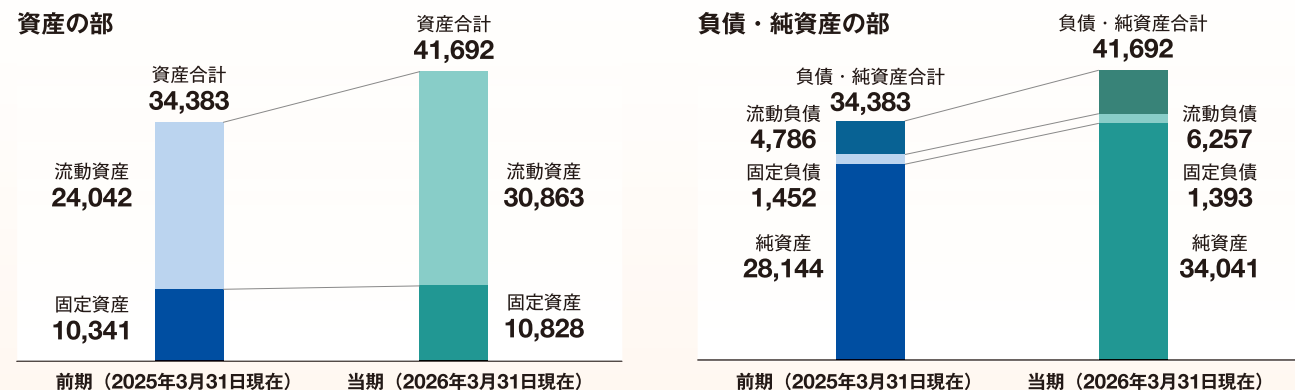
上野 当社グループとしては、これまでに培ってきた「技術力」「現場力」を軸に、光製品事業、精機事業それぞれの特性を活かした成長戦略を進めていきます。光製品事業では成長ドライバーである光コネクタ・研磨機の分野へ積極的に経営資源を投入。開発から組立、研磨、治工具の設計、テスト、梱包までの一貫体制をさらに強固にします。一方、精機事業においては、最大の強みである「高精度・高難度加工」のブラッシュアップに取り組み、収益基盤の安定化をはかります。そしてセグメントを横断して「技術力」「現場力」と突発的な課題への対応力を高め、市場環境の変化に対応します。株主・投資家の皆様におかれましては、精工技研の中長期的な成長力と、それを支える組織力にご期待いただきたいと思います。



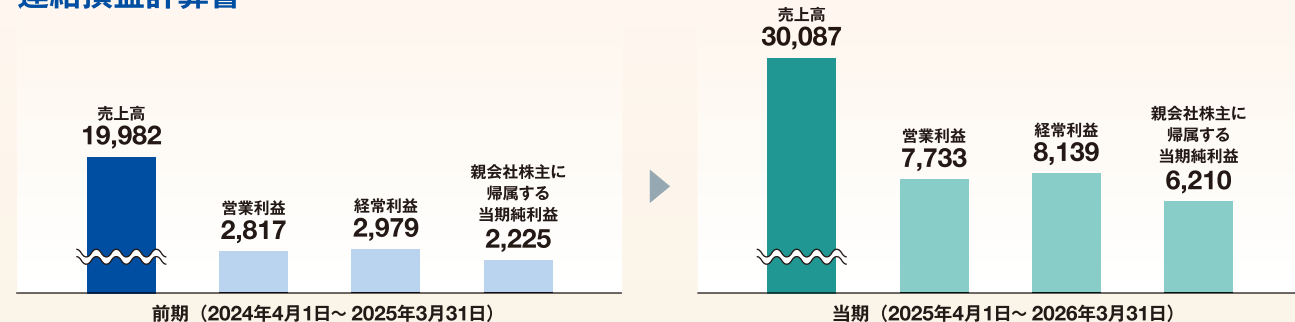
連結財務諸表(要約)

単位：百万円、単位未満切り捨て

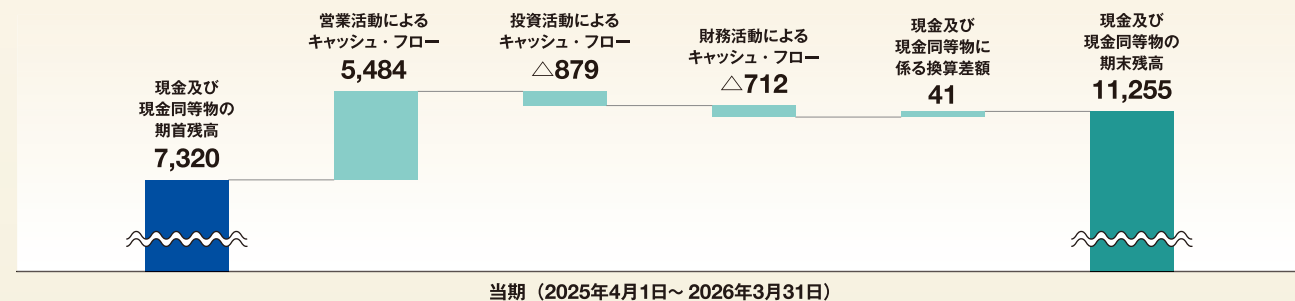
連結貸借対照表



連結損益計算書



連結キャッシュ・フロー計算書



会社情報 / 株式情報

会社概要 (2026年3月31日現在)

会社名 株式会社 精工技研
 本社所在地 千葉県松戸市松飛台296番地の1
 創業 1972年6月
 資本金 6,791,682,700円
 事業内容 **精機事業**

自動車用部品、電子部品等の精密成形品や各種精密金型、精密金属部品等の製造および販売

光製品事業

光通信用設備に用いる光部品や光部品製造機器、光部品形状測定装置、無給電光伝送装置、光電界センサ、高耐熱レンズ等の製造および販売

従業員数 1,231人

グループ会社

子会社
 SEIKOH GIKEN USA, INC.
 杭州精工技研有限公司
 SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH
 大連精工技研有限公司
 不二電子工業株式会社
 DATA-PIXEL SAS
 SEIKOH GIKEN (THAILAND) Co., Ltd.
株式会社エムジー
 精工讯捷光电(杭州)有限公司
 精工讯捷光电(鹤壁)有限公司

関連会社等

浙江精工光电科技有限公司
 蘇州安准智能装备有限公司

役員 (2026年6月19日現在)

代表取締役社長	上野 淳
専務取締役	來 関明
取締役	斎藤 祐司
取締役	角野 清行
取締役(社外取締役)	谷田貝 豊彦
取締役(監査等委員、社外取締役)	相場 俊夫
取締役(監査等委員、社外取締役)	三好 慶
取締役(監査等委員、社外取締役)	森川 有理

株式の状況 (2026年3月31日現在)

発行可能株式総数	37,000,000株
発行済株式の総数	9,333,654株
株主数	5,137名

所有者別株式分布状況 (2026年3月31日現在)

